

重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次报告的董事会会议。

非审计意见提示

□适用 √不适用

董事会对报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股股利分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋海	丁燕	
办公地址	江苏省南通市崇川区288号	江苏省南通市崇川区288号	
电话	0513-85158919	0513-85059199	
电子信箱	fime_stock@fime.com	fime_stock@fime.com	

2. 报告期内公司从事的主要业务

(1) 公司主要业务情况

公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G等网络通信、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样需求。

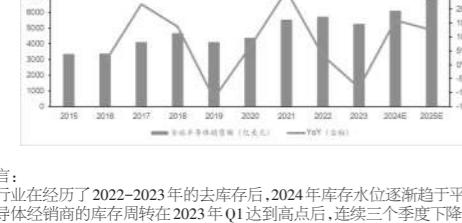
公司总部位于江苏南通，拥有全球化的制造和服务网络，在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城和日本大生产基地，实现了效率和高质量的生产能力，为全球客户提供快速和便捷的服务，在全球拥有近两万名员工。公司与客户紧密合作，致力于成为国内集成电路封测企业，通过技术创新、市场拓展和产能提升等措施，不断提升公司的市场竞争力和地位。同时，公司也将积极响应国家产业政策导向，依托国家产业基地的支持，抓住集成电路产业链快速发展的历史机遇，为推动我国集成电路产业的进步和发展做出贡献。报告期内，公司的经营模式未发生改变。

(2) 公司所处行业情况

2024年上半年半导体市场需求情况

在信息技术发展的浪潮中，半导体与集成电路不仅是璀璨夺目的星辰，更是驱动整个经济社会高速发展的核心引擎之一。作为战略性、基础性和先导性产业，它们不仅承载着技术创新的重任，还是保障国家安全、促进产业链升级的关键力量。2024年以来，全球半导体行业呈现温和复苏态势，据半导体行业协会(SIA)统计，2024年上半年全球半导体销售额相较于2023年同期增长；从单季来看，2024年Q2全球半导体销售额同比环比均实现增长，行业呈现持续改善态势，同时，半导体行业协会(SIA)预计2024年全年半导体销售额亦将实现大于10%的增长。

图表: 2015-2025年全球半导体销售额及预测(单位:亿美元)



来源: SIA

具体而言：

半导体行业在经历了2022-2023年的库存周期后，2024年库存水位逐渐趋于平稳健康。IC设计公司由于经济周期的影响在2023年Q1达到历史高位，之后三个季度下降，并在2023年Q4触底，2024年Q1末平均周存货天数降至69.78天，表明行业库存进入顺利去化阶段。

从下游应用领域看，AI需求爆发驱动逻辑和高端存储需求快速增长，消费电子回暖复苏，2024年上半年全球智能手机销量5.75亿部，同比增长7.2%，中国2024年6月18日货物节智能手机全球销量同比增长7.4%；据SEMI统计，消费电子复苏带动全球IC库存水平同比下降2.6%，而在汽车行业，2024年上半年整体需求较弱，展望至下半年，随着车规级芯片广泛应用于芯片市场逐步触底，汽车行业有望重归增长。

在行业整体复苏向好的同时，在AI引领催化下产业链正迎来加速发展。一方面，AI需求爆发带动对先进封装技术的需求；另一方面，AI算法正在从训练到推理，从云端到端侧的转向，这种趋势或将引领先进封装技术真正变得日益多元。

2024年7月25日，国家发展改革委、财政部印发《关于加快支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，安排财政资金300亿元左右长期特别国债资金，加大对大规模设备更新和消费品以旧换新。在消费品以旧换新方面，该措施将个人消费者乘用车置换更新，家电产品和电动汽车以旧换新等；并纳入超长短期特别国债资金支持范围。东证认为，随着国家以旧换新的政策力度加大，家电、汽车等消费品的更新周期有望进一步加速，家电领域的智能化和网联化有望拉动对WiFi、蓝牙等无线连接芯片的需求，汽车产业自主品牌渗透率持续提升也有望带来积极影响，MCU、传感器等本土产业链有望崛起。

2024年7月26日，国务院办公厅“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，国务院国资委科技局负责人方磊表示，国务院国资委将加快发展人工智能作为产业焕新行动和自航行动部署的主要方向，开展“AI+”专项行动，致力于加快推进以应用示范牵引人工智能产业发展。

(3) 报告期公司经营情况

1) 增行业复苏势头，各类行业稳步提升

2024年起，随着计算和移动设备等消费电子产品市场的回暖，全球半导体行业迎来了明显复苏势头。

上半年，在消费电子市场，公司持续紧抓手机及消费电子复苏机遇，传统框架类产品市场竞争稳定，营收实现不降反升。在新兴市场方面，射频产品市场份额替代势如破竹，公司把握先机，系统级(SoP)封装技术的领先地位，产品不断上量，持续扩大市场规模；同时，存储器(Memory)、显示驱动(Panel Driver)、FC产品线也展现出强劲增长势头，保持超50%的高速增长，展现了公司新产品驱动市场的市场竞争力和生产效率。

上半年，AI芯片市场快速增长。根据Gartner预测，2024年全球AI芯片市场规模将增长33%，达到713亿美元，2025年有望进一步增长29%，达到920亿美元；2024年服务器AI芯片市场规模预计将增长20%，达到300亿美元，2025年有望增长30%，达到330亿美元。CAGR为12%。公司客户AMD的数据中心业务增长预期，得益于客户和企业客户对Instinct GPU和EPYC处理器的强大需求，其中M100 GPU单卡预期收入10亿美元，AMD上修今年数据中心GPU收入为45亿美元，此前为40亿美元。随着AI芯片需求的暴涨，先进封装产能成为了AI芯片出货的瓶颈。

一、台积电、日月光、安靠均表示先进封装产能紧张，相关订单需求旺盛。在先进封装技术方面，公司持续发力服务器和云端市场大尺寸算力产品，依托与AMD等行业龙头企业多年的合作积累与产能优势，基于高密度处理器和AI芯片封测需求的不断增长，公司上半年高性能封装业务保持稳步增长。同时，随着AI+行业的新机会增多，人工智能产业化进入新阶段，公司配合AMD等头部公司在人工智能发展的机遇，积极扩产扩能，工厂、产能方面满足客户需求。

机遇往往与挑战共存，上半年市场竞争异常激烈，导致产能过剩，全球游戏机市场整体呈现低靡状态。面对上半年市场竞争，公司积极采取应对措施，通过优化客户结构等方法来深耕国内市场对公司的潜在影响，通过构建更加强健和多元化的客户基础，增强公司在不断变化的市场环境中的适应能力和竞争力。

得益于公司战略定位和经营策略的有效执行，2024年上半年，公司实现营业收入110.80亿元，同比增长11.83%。

公司凭借有效的成本控制、先进的技术能力以及快速响应和优质服务等方面的优势表现，连续四年荣获德州仪器(TI)“年度供应商”奖项。通富超威苏州连续8次在AMD季度质量评分中获得第一名。

在当前半导体产品的复杂多变形势下，公司凭借卓越的技术创新能力、优良的产品品质以及客户的服务态度，获得了市场的高度认可。公司目前已成为多家客户本土化生产的首选合作伙伴。公司将在全方位助力客户实现技术突破和产品升级，共同开拓更广阔的市场空间。

展望下半年，我们认为消费市场仍然会维持复苏状态，同时，算力需求将保持增长，工况和车规市场逐步触底，芯片与车芯的竞争仍然可控。公司在汽车电子领域已深耕20余年，与全球主流汽车半导体厂商深度合作，积累了丰富的经验，在汽车电子领域的份额占比保持领先，并逐年提升。同时，公司将持续夯实欧洲头部客户的基础，积极开拓海外市场，扩大国际市场营收。

在先进封装布局方面，公司面向高端处理器等产品领域持续投入，进一步加大研发力度，布局更高品质、更高性能、更先进的封装平台，全方位开拓海内外客户的发展需求，拓展先进封装产品版图，为新一轮的需求及业务增长夯实基础，带动公司在先进封装产品领域的业绩成长。

2) 公司技术研发水平不断提升

2024年上半年，公司对大尺寸多芯片Chiplet封装技术升级，针对大尺寸多芯片Chiplet封装技术，新开发了Corner GDI CPE等工艺，增强对chip的保护，可靠性得到进一步提升。公司启动基于碳基板和玻璃基板的FCBGA芯片封测技术，开发面向光通信、消费电子、人工智能等领域对高密度、高质量、高可靠性的需求，此项技术有助于提高高密度、高良率、高可靠性的封装技术的开发。目前已完成初步验证。Power方面，公司上半年完成了Easy3B模块的研发，开始进入小批量量产。国内首家采用Cu底座灌胶模块，应用于太阳能逆变器，相较于市场的传统EAS1B、2B模块，能更有效的降低系统的热阻及功耗。2024年上半年，公司16层芯片堆叠封装产品大批量出货，合格率居业内领先水平；国内首家WB分腔屏蔽技术、Plastic-molding技术进入量产阶段。

截至目前，公司在知识产权方面取得了显著成果。累计申请专利达1,589件，其中发明专利占比近70%，同时，累计获授权1,393件。在江苏省高价值专利培育项目中期检查中，公司获评“优秀”。

3) 重大工程建设稳步推进，保障发展空间

2024年上半年，通富微电、南通通富三期工程、通富超威苏州、通富超威成都新工厂等一

通富微电子股份有限公司

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2024-058

2024半年度报告摘要

本公司董事会有权决定是否将报告摘要全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次报告的董事会会议。

非审计意见提示

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股股利分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋海	丁燕	
办公地址	江苏省南通市崇川区288号	江苏省南通市崇川区288号	
电话	0513-85158919	0513-85059199	
电子信箱	fime_stock@fime.com	fime_stock@fime.com	

2. 报告期内公司从事的主要业务

(1) 公司主要业务情况

公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G等网络通信、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样需求。

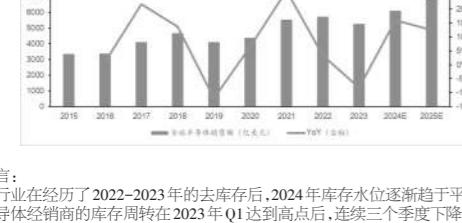
公司总部位于江苏南通，拥有全球化的制造和服务网络，在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城和日本大生产基地，实现了效率和高质量的生产能力，为全球客户提供快速和便捷的服务，在全球拥有近两万名员工。公司与客户紧密合作，致力于成为国内集成电路封测企业，通过技术创新、市场拓展和产能提升等措施，不断提升公司的市场竞争力和地位。同时，公司也将积极响应国家产业政策导向，依托国家产业基地的支持，抓住集成电路产业链快速发展的历史机遇，为推动我国集成电路产业的进步和发展做出贡献。报告期内，公司的经营模式未发生改变。

(2) 公司所处行业情况

2024年上半年半导体市场需求情况

在信息技术发展的浪潮中，半导体与集成电路不仅是璀璨夺目的星辰，更是驱动整个经济社会高速发展的核心引擎之一。作为战略性、基础性和先导性产业，它们不仅承载着技术创新的重任，还是保障国家安全、促进产业链升级的关键力量。2024年以来，全球半导体行业呈现温和复苏态势，据半导体行业协会(SIA)统计，2024年上半年全球半导体销售额相较于2023年同期增长；从单季来看，2024年Q2全球半导体销售额同比环比均实现增长，行业呈现持续改善态势，同时，半导体行业协会(SIA)预计2024年全年半导体销售额亦将实现大于10%的增长。

图表: 2015-2025年全球半导体销售额及预测(单位:亿美元)



来源: SIA

具体而言：

半导体行业在经历了2022-2023年的库存周期后，2024年库存水位逐渐趋于平稳健康。IC设计公司由于经济周期的影响在2023年Q1达到历史高位，之后三个季度下降，并在2023年Q4触底，2024年Q1末平均周存货天数降至69.78天，表明行业库存进入顺利去化阶段。

从下游应用领域看，AI需求爆发驱动逻辑和高端存储需求快速增长，消费电子回暖复苏，2024年上半年全球智能手机销量5.75亿部，同比增长7.2%，中国2024年6月18日货物节智能手机全球销量同比增长7.4%；据SEMI统计，消费电子复苏带动全球IC库存水平同比下降2.6%，而在汽车行业，2024年上半年整体需求较弱，展望至半年，随着车规级芯片广泛应用于芯片市场逐步触底，汽车行业有望重归增长。

展望未来，公司将继续坚持人才优先的战略导向，不断深化人才培养、发展与激励机制，为公司的持续创新和稳健增长奠定了坚实的基础。

4. 公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数

前10名股东持股情况(不含通过回购专用账户持有的股)

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有无限售条件的股份数量 股份状态 数量

南通通富 境内法人 19.90% 301,941,993 0 质押 91,510,000

国家集成电路基金 0 国有法人 11.26% 170,817,547 0 不适用

香港中央结算有限公司 0 国外法人 3.46% 52,480,179 0 不适用

苏州国泰资本管理有限公司 0 其他 3.36% 50,932,648 0 不适用

华芯投资管理有限公司-华芯投资二期股权投资基金 0 其他 1.58% 23,999,036 0 不适用